|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **时间** | **备注** |
| **1** | 硬件测试 | 1、硬件电路及风扇、激光管  测试  2、DAC门限设置及测试  3、粒径分离门限设置及测试 | 已完成 |  |
| **2** | PM25固件 | 1、算法实现  2、校准流程功能实现  3、整片加密算法实现 | 固件与上位机联调时间：1周  加密固件编写及测试时间：3天 | 算法、校准软件已调试并验证完成。 |
| **3** | PI 固件 | 1、上位机通信  2、校准数据拟合，分段生成kb及测试结果判定  3、下位机通信 | 与下位机通信及调试时间：1周  程序优化时间：1周 | 本周上下机联合通信成功。  有待优化的内容是异常情况的处理，计划下周处理 |
| **4** | 后台 | 1、校准流程功能实现  2、界面实现  3、tsi数据获取  4、数据log保存 | 代码编写完成。待联调测试 |  |
| **序号** | **项目** | **内容** | **时间** | **备注** |
| **1** | 后台、pm模块、pi联调 | 测试软件整体流程 | 7.3—7.10 |  |
| **2** | 整体一对一测试（小环境） | 软硬联调，测试软件解决BUG | 7.11—7.12 |  |
| **3** | 整体一对五测试（小环境） | 软硬联调，测试软件解决BUG | 7.13—7.17 |  |
| **4** | 整体一对一测试（大环境） | 在大环境下，验证校准测试软件 | 7.18—7.25 | 保证每段采样点至少100个。  风险：大环境不确定性可能会延期 |
| **5** | 整体一对五个pi测试（大环境） | 在大环境下，验证校准测试软件 | 7.26-7.31 | 风险：大环境不确定性可能会延期 |

**模块校准测试计划**